

Presseinformation

PolyIC GmbH & Co. KG: Februar 2007

PolyIC ist jüngstes Mitglied im größten EU-Förderprojekt für organische Elektronik „PolyApply“ – Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von in-line Fertigungsprozessen und eines 13,56 MHz RFID-Demonstrators

Das EU - Förderprojekt „PolyApply“ („The application of polymer electronics towards ambient Intelligence“) legt mit seinen Mitgliedspartnern die Grundlage für eine universell einsetzbare Technologie basierend auf organischer Elektronik. Neben den notwendigen Materialien und Prozessen werden insbesondere RFID-Demonstratoren für eine Radiofrequenz von 13,56 MHz aufgebaut. Der Schlüssel zu deutlich geringeren Kosten gegenüber den heute üblichen Silizium-RFID-Tags ist die konsequente Einführung von neuen in-line- und insbesondere Rolle-zu-Rolle - Fertigungstechnologien.

PolyIC ist seit 1. September 2006 jüngstes Mitglied bei „PolyApply“. Andere Mitglieder sind z.B. Merck, Motorola und Philips Research Laboratories. „PolyIC arbeitet seit dem Beitritt mit daran, die Kompetenzen aller Mitglieder zusammen zu bringen, um gemeinsam einen organischen RFID – Tag aufzubauen“, sagt Dr. Wolfgang Clemens, Head of Applications bei der PolyIC GmbH & Co. KG. PolyIC steuert hierzu insbesondere polymere Transistoren und integrierte Schaltungen bei.

PolyIC leitet das Arbeitspaket „Manufacturing and Process“ und engagiert sich neben der Entwicklung der Demonstratoren nun besonders im Bereich der Evaluierung von neuen Materialien für organische Elektronik in Referenzaufbauten und in Rolle-zu-Rolle - Prozessen, sowie in der Entwicklung von polymeren Schaltungen zur Auswertung von Sensor- und Speicherchips.

„PolyApply“ ist ein Integriertes Projekt im 6. Rahmenprogramm der Europäischen Union und wird mit etwa 20 Millionen € gefördert, davon sind 12 Millionen € Fördergelder von der Europäischen Union. Die Differenz von 8 Millionen € wird von den insgesamt fast 20 Mitgliedern des Konsortiums beigesteuert. Das Projekt hat im Januar 2004 begonnen und läuft bis Ende 2007. Mehr Informationen unter www.polyapply.org.

PolyIC GmbH & Co. KG: 2007

PolyIC ist führend in der Entwicklung von Polymerelektronik - Bauteilen und ein Anbieter von Produkten und Komponenten mit gedruckter Elektronik. PolyIC wird Low-Cost Elektronik - Produkte für den Massenmarkt bereitstellen, basierend auf organischen Halbleitern.

PolyIC setzt hierzu seine Materialkompetenz, neue adaptierte Methoden des Chip-Designs und Prozesse für die Massenproduktion (z.B. Rollendruck) ein, um diese neue Technologie zu entwickeln. Die Leitapplikation für PolyIC ist RFID (Radio Frequency Identification). Die Firmentechnologie hat das Potential, in vielen verschiedenen Applikationen eingesetzt zu werden die Eigenschaften wie dünn, flexibel und Low-Cost Elektronik verlangen. PolyIC ist Mitglied der EPCglobal – einer globalen Organisation zur RFID Standardisierung. www.epcglobal.de/

PolyIC ist Gründungsmitglied der Organic Electronics Association, eine Arbeitsgemeinschaft im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau).
www.oe-a.org

PolyIC GmbH & Co. KG wurde im November 2003 als Joint Venture zwischen der Leonhard Kurz GmbH & Co. KG (51%, Beschichtungen und Heißprägetechnologie) und der Siemens AG (49%, Elektronik) für die Entwicklung und Produktion der gedruckten Polymerelektronik gegründet. Der Standort von PolyIC ist in Fürth, auf dem Gelände der Leonhard Kurz GmbH & Co. KG.

PolyIC ist im Internet erreichbar unter www.polyic.com.